

## JDB910 有机硅导热灌封胶 (R07)

### 产品描述

JDB910 有机硅导热灌封胶(R07)是一种室温或加温固化的双组分加成型有机硅材料。这种双组分弹性硅胶设计用于灌封、保护处在严苛条件下的电子产品。使用时按照 1:1 (重量比)的比例彻底混合 A、B 两组分后,产品会在一定时间内固化,形成弹性的缓冲材料。

### 产品特性

- 粘度低、流动性好,可渗入细小元器件缝隙;
- 抵抗湿气,污物和其它大气组分;
- 无溶剂,无固化副产物,容易修补;
- 减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力;
- 在-50~200℃间稳定的机械和电气性能;
- 阻燃性能优异,通过了 UL94V0 认证 (UL FileNo.E343835),完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

### 产品用途

产品用于传感器、电源模组,太阳能电池、LED 驱动模块、逆变器等场合灌封。

### 主要性能

项目		典型值		测试标准
<b>混合前物性 ( 23±2℃/50±5%RH )</b>				
组分	--	A	B	--
外观	--	黑色流体	白色流体	--
粘度 (Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min)	MPa·s	3000±500	3000±500	GB/T 2794-2013
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.60±0.10	1.60±0.10	GB/T 533-2008
<b>混合后物性 ( 23±2℃/50±5%RH )</b>				
重量比混合	--	A:B=1:1		GB/T 533-2008
外观	--	灰色流体		---
粘度 (Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min)	MPa·s	3000±500		GB/T 2794-2013
操作时间 (25℃)	min	30 (可调控范围 15~120min)		GB/T 13477.5-2002
固化时间 (25℃)	h	6(可调控范围 3~24h)		GB/T 13477.5-2002

完全固化时间(80℃)	min	30	GB/T 13477.5-2002
<b>固化后性能</b> ( 23±2℃/50±5%RH×24hours )			
硬度	Shore A	50±5	GB/T 531.1—2008
导热系数	W/m·K	0.7±0.1	ISO22007-2
拉伸强度	Mpa	≥1.2	GB/T 528—2009
介电强度	kV/mm	15	GB/T 1408.1—2006
体积电阻率	Ω·cm	≥2.5×10 <sup>14</sup>	GB/T 1410—2006
介电损耗(60HZ)	--	0.02	GB/T 1409—2006
工作温度	℃	-50~200	--

### 使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净，并保持洁净表面干燥。
- 储存中的A, B两个部分在混合前，各自要充分的搅拌均匀。
- 1: 1质量比混合使用，倒入4倍于胶体体积的容器中，以防脱泡过程中胶体膨胀溢出。
- 混合后可用真空方式去除夹带空气，在28”Hg的真空度下抽气，2分钟可去除气泡，大容积时可延长抽空气时间。

### 注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 胶料应密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 本品属非危险品，但避免接触皮肤及眼睛。
- 长时间存放后，胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会导致胶不固化：
  - 1、含N、P和S等的有机化合物。
  - 2、含Sn、Pb、Hg和As等元素的离子性化合物。
  - 3、含炔烃及多乙烯基的化合物。
- 为了避免上述现象，胶液灌封使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

### 包装规格

- A组分，25kg/桶。
- B组分，25kg/桶。

### 储存及运输

- 远离儿童存放，保持A、B组分避光和避热，并且密封保存。
- 在28° C或低于该温度未开封保存时，产品自生产之日起保质期为6个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

### 请仔细阅读：

本说明书提供的各种数据均为特定条件下测试所得，仅作为参考，为确保材料在最终使用条件下的安全和适用，客户有必要通过实验确认产品的适用性。在使用过程中有任何问题，请与我们联系，我们将利用我们的专知和加工经验为您提供服务。